SIEMENS

Halbleitertechnologie und Umgang mit Gefahrstoffen (MIHL_EXT)

Short Description

Die Qualitätsansprüche an die Fertigung im Reinraum sind enorm und unterliegen stetigen Veränderungen. Mit diesem Seminar der Halbleitertechnologie werden Sie praxisorientierte Kenntnisse erlangen, wie die Strukturen auf das Silizium aufzubringen sind und erweitern ihre Kompetenzen in chemischen und physikalischen Verfahren. So z.B. werden Sie das Beschichten, Belacken, Belichten, Entwickeln und Ätzen von Wafern technologiebezogen herausarbeiten und dabei den Schwerpunkt auch auf den sicheren Einsatz von Gefahrstoffen in der Fertigung legen. Das Training wird durch die fachspezifische Einbindung eines generativen KI-Assistenten ergänzt.

Objectives

In der Mikrotechnologie wird eine Start- und kontinuierliche Mitarbeiterschulung erwartet, um die hohen Qualitätsansprüche dauerhaft zu gewährleisten

Target Group

Fertigungsmitarbeitende in der Waferherstellung oder vergleichbaren Aufgaben der Mikrosystemtechnik

Content

Einführung Halbleitertechnologie

Dotierung

Schichterzeugung

Fototechnik

Ätztechnik

Backendtechnologien

Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen

Fachspezifische Nutzung generativer KI-Assistenten

Prerequisites

Interesse an Hightec- Fertigungsprozessen der Halbleitertechnologie

Type

Classroom Training with Digital Interfaces

Duration

3 days

Language

de

copyright by Siemens AG 2026